

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 关于为子公司士兰明镓提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● **被担保人名称：**厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）。士兰明镓为本公司之控股子公司。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

公司本次拟为士兰明镓3亿元项目贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为士兰明镓实际提供的担保余额为2.36亿元。

● **本次担保无反担保**

● **公司不存在逾期对外担保**

### 一、担保情况概述

1、本公司之控股子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）拟向国家开发银行厦门市分行申请项目贷款人民币3亿元，用于“SiC功率器件生产线建设项目”建设，贷款期限12年。本公司拟为士兰明镓该笔贷款本金及利息等费用提供全程全额第三方连带责任保证担保。同时，士兰明镓以该项目形成的主要工艺设备提供抵押担保。

2、本次担保不构成关联担保。本次担保无反担保。士兰明镓其他股东未提供同比例担保。

3、截至本公告披露日，公司为士兰明镓实际提供的担保余额为2.36亿元。

4、2024年4月23日，公司召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司士兰明镓提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人士兰明镓的基本情况

公司名称	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司
统一社会信用代码	91350200MA31GA8D5D

成立时间	2018年2月1日
注册地址	厦门市海沧区兰英路99号
法定代表人	陈向东
注册资本	2,460,382,891.96元（已足额缴纳）
企业类型	其他有限责任公司
主营业务	化合物半导体芯片制造
资产负债率	55.60%

## 2、士兰明镓现有股权结构：

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例（%）	出资方式
杭州士兰微电子股份有限公司	1,184,869,057.47	48.16	货币
厦门半导体投资集团有限公司	829,259,000.00	33.70	货币
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	347,087,093.49	14.11	货币
厦门海创发展股权投资合伙企业（有限合伙）	99,167,741.00	4.03	货币
<b>合计</b>	<b>2,460,382,891.96</b>	<b>100.00</b>	-

## 3、士兰明镓最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项 目	2023年9月末/2023年1-9月 （未经审计）	2023年末/2023年度 （经审计）
资产总额	223,693	314,787
负债总额	180,906	175,028
净资产	42,787	139,759
营业收入	36,971	53,912
净利润	-25,141	-33,169

4、士兰明镓为本公司之控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议。在获得股东大会审议通过的前提下，公司提请授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

## 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足子公司士兰明镓“SiC 功率器件生产线建设项目”建设的资金需求，有利于公司主营业务的发展。被担保人士兰明镓生产经营

稳定，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。

士兰明镓为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险处于公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、董事会意见

公司于2024年4月23日召开的第八届董事会第二十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司士兰明镓提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。在股东大会批准本次担保事项的前提下，公司提请授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

## 六、公司担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为48.066亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.98%。公司对控股子公司提供的担保总额为39.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.15%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为8.216亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年4月24日